

广东德豪润达电气股份有限公司

关于非公开发行股票会后事项的专项说明

中国证券监督管理委员会：

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“德豪润达”、“公司”）2016年度非公开发行股票已于2016年12月7日经贵会核准。

公司2017年半年度报告显示，公司实现归属上市公司股东的净利润-6,716.18万元，较上年同期1,603.63万元同比下降518.81%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为-16,745.71万元，较上年同期-9,838.40万元同比下降70.21%。

根据贵会颁发的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第5号）的规定，公司对有关事项出具本专项说明，情况如下：

一、2017年半年度业绩情况及变动因素分析

公司2017年半年度主要经营数据以及较上年同期业绩变动对比如下：

单位：万元

项目	2017年半年度	上年同期	同比变动
营业收入	192,338.99	170,703.51	12.67%
营业成本	153,423.10	137,278.06	11.76%
营业利润	-16,791.95	-10,878.72	54.36%
净利润	-4,046.33	2,770.61	-246.04%
归属于上市公司股东的净利润	-6,716.18	1,603.63	-518.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,745.71	-9,838.40	-70.21%

公司2017年半年度主要经营数据较去年同期下降的主要原因系小家电业务

产生了较大的汇兑损失：公司的小家电业务以出口为主，主要以美元定价，2017年上半年，由于人民币兑美元汇率不断上升，2017年1-6月累计发生7,586.61万元汇兑损失，而上年同期人民币兑美元持续贬值，累计发生了4,921.74万元汇兑收益。因此，2017年1-6月财务费用-汇兑损失同比增加了12,508.35万元，增长幅度为254.14%。

综上，除上述汇率波动外，公司经营未产生其他重大不利变化。公司2017年1-6月净利润下滑主要受汇率变动导致的汇兑损失大幅增加，公司仍然符合非公开发行股票的条件。

二、业绩变动因素对本次募集资金投资项目的影响

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币200,000.00万元（含200,000.00万元），在扣除发行费用后净额将用于LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目。公司LED业务的供应商、客户主要来自国内，汇率变动未对公司的LED业务造成影响。

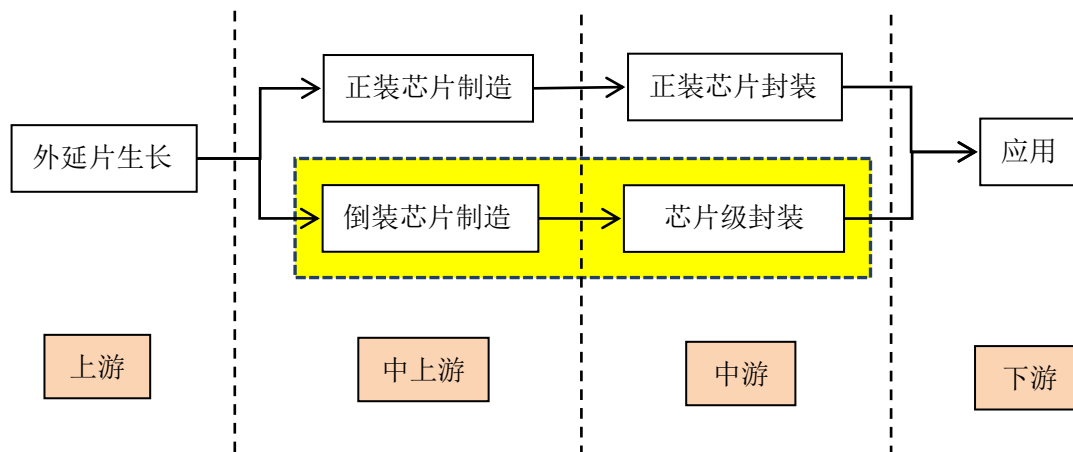
本次募集资金具体投资项目如下：

序号	项目名称	计划投资（万元）	拟用募集资金投入（万元）
1	LED倒装芯片项目	250,000	150,000
2	LED芯片级封装项目	150,000	50,000
合计		400,000	200,000

2017年半年度业绩亏损不会对公司本次募投项目构成重大不利影响：

（1）公司本次募集资金投资项目和公司现有产品分属不同的工艺技术路线

公司本次募集资金将投资于倒装芯片的生产环节及倒装芯片相应的芯片级封装环节。本次募投项目与公司现有LED产业链的关系如下图所示：



注：黄色区域内的环节为本次募投项目拟投资的环节。

由上图可见，倒装芯片及芯片级封装与现有正装芯片及封装在 LED 产业链上分属不同的技术和工艺路线，其上游均为外延片产品，下游均为照明等应用产品，但是在下游应用产品中，倒装芯片及芯片级封装的应用领域更为广泛。

倒装芯片及芯片级封装产品相比于正装芯片及封装产品技术门槛更高，性能更加优异，可靠性更高；同时由于芯片级封装减少了金线和支架，生产成本更低；此外，倒装芯片及芯片级封装产品凭借其大功率、高光通量、高可靠性的优势，可应用于正装芯片及其封装无法胜任或者不具有经济性的领域，如户外照明、汽车照明、工业照明、手机及相机闪光灯等高端领域，较正装芯片及封装产品应用领域更为广泛。

(2) 本次募集资金投资项目实施将有利于匹配公司产业链，提升现有资产的使用效率

与正装芯片相同，倒装芯片的上游环节也是外延生长。目前公司的 MOCVD 产能尚未充分利用，而正装芯片竞争异常激烈，新增倒装芯片的产能可以更有效地匹配产业链前端的 MOCVD 产能，提升 MOCVD 设备的使用效率。另一方面，倒装芯片及其封装可以有效降低下游应用产品的成本，提升应用产品的竞争力，也将提高公司下游应用产品的产能利用率，更好地匹配下游应用产品的产能，提升公司整体的产能利用率和现有资产的使用效率。

(3) 公司倒装芯片及相关产品尚未实现产业化，但已经积累大量优质客户

公司自主研发的 LED 倒装芯片于 2014 年度开始投放市场，2015 年和 2016 年实现小规模生产并销售，取得良好市场反应和客户认可，但由于项目所需资金尚未到位，未实现产业化生产。公司倒装芯片主要为高亮度，中、大功率产品，其下游应用主要为室外照明、工业照明、汽车灯以及手机闪光灯等领域。公司凭借倒装芯片的技术优势和价格优势，在手机闪光灯、汽车照明以及户外照明等领域储备了大量新的优质客户，包括魅族、联想和中兴等手机厂商或其方案商，雪莱特（002076）、佛山照明（000541）等汽车照明厂商，该部分客户与公司目前的正装芯片客户重叠度较小，发行人为开展倒装芯片业务进行了充分的客户储备。

（4）发行人募投项目主要供应商、客户在国内，受汇率直接影响较小

发行人本次募投项目为 LED 倒装芯片项目和 LED 芯片级封装项目，主要运用公司现有产能提供外延片作为原材料，客户包括魅族、联想和中兴等手机厂商或其方案商，雪莱特（002076）、佛山照明（000541）等汽车照明厂商等，其市场主要在国内。因此，发行人本次募投项目的实施以国内市场为主，直接受汇率波动的影响较小。

三、信息披露情况

（一）发审会后经营业绩变化情况，或者其他重大不利变化，在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险

2016 年 12 月 7 日，中国证监会发审委对公司非公开发行股票申请进行了审核。发审会前后，公司的经营业绩一直相对平稳，2015 年和 2016 年，公司归属母公司所有者的净利润分别为 1,986.21 万元和 3,171.99 万元。2017 年上半年公司净利润有所下滑，主要与人民币汇率波动因素有关，此种情形在发审会前可以合理预计，公司在发审会前已经充分提示了风险：公司分别在 2016 年 4 月 15 日《非公开发行预案》中提示了公司“经营业绩下滑的风险”，公司还曾在定期报告中多次提示公司“汇率变动风险”。

（二）发审会后经营业绩变动的影响因素，或者其他重大不利变化，是否将

对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

2017 年上半年的业绩变化主要与人民币汇率波动有关，其市场环境和公司的经营模式并未发生根本性的变化，随着发行人加快推进 LED 倒装芯片项目、LED 芯片级封装项目顺利推进，发行人未来业务发展依然向好，预计不会对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响。

四、上述事项对公司本次非公开发行的影响

截至目前，发行人本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。因此，发行人 2017 年上半年业绩波动情况不会对本次非公开发行产生重大影响，不会导致发行人不符合非公开发行条件。

五、中介机构核查意见

（一）保荐机构核查意见

保荐机构认为，德豪润达 2017 年半年度归属于上市公司股东净利润的下滑不会对本次非公开发行及募集资金投资项目的实施产生重大不利影响；德豪润达已对业绩变动情况及原因及时作出了充分的信息披露。因此，德豪润达仍然符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

（二）会计师核查意见

会计师认为，德豪润达 2017 年半年度归属于上市公司股东净利润的下滑不会对本次非公开发行及募集资金投资项目的实施产生重大不利影响；德豪润达已对业绩变动情况及原因及时作出了充分的信息披露。因此，德豪润达仍然符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

（三）发行人律师核查意见

律师认为，德豪润达 2017 年半年度归属于上市公司股东净利润的下滑不会对本次非公开发行及募集资金投资项目的实施产生重大不利影响；德豪润达已对业绩变动情况及原因及时作出了充分的信息披露。因此，德豪润达仍然符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东德豪润达电气股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》之盖章页）



广东德豪润达电气股份有限公司

2017年 9月 18日